

国泰海通证券股份有限公司  
关于英韧科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市  
之  
上市保荐书

保荐人（主承销商）



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

## 声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”或“国泰海通”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

## 目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
一、 发行人概况.....	3
二、 申请上市股票的发行情况.....	12
三、 本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	12
四、 保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责的情形的说明.....	13
五、 保荐人承诺事项.....	14
六、 发行人就本次证券发行上市履行的决策程序.....	15
七、 保荐人关于发行人符合科创板定位的核查意见.....	16
八、 保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明.....	30
九、 保荐人对发行人持续督导工作的安排.....	35
十、 保荐人对本次发行上市的推荐结论.....	36

## 一、发行人概况

### （一）发行人基本资料

中文名称	英韧科技股份有限公司
英文名称	InnoGrit Technologies Co., Limited
注册资本	43,026.1427 万元人民币
法定代表人	刘刚
有限公司成立日期	2017-06-27
股份公司成立日期	2023-10-11
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 40 号 601-606 室（名义楼层 6 层，实际楼层 5 层）
邮政编码	201210
互联网网址	<a href="https://www.yingren.cn">https://www.yingren.cn</a>
电子邮箱	investor@yingren.cn
信息披露和投资者关系管理部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人	金昊
信息披露和投资者关系管理部门电话号码	021- 61099118

### （二）主营业务情况

公司是国际领先的数据存储主控芯片与半导体存储产品提供商，主营业务为数据存储主控芯片和固态硬盘（SSD）的研发、设计及销售，完整覆盖企业级、工业级和消费级应用。公司以 AI SSD 为代表的企业级产品为核心，依托自主研发能力，突破人工智能等前沿领域在数据存储与传输方面的关键技术瓶颈，实现信息存储核心环节的自主可控，产品广泛应用于 AI 驱动的算力中心、云服务等前沿场景。目前，公司产品已成功导入客户 B、腾讯、客户 A、联想、新华三、客户 C 等主流国产互联网、云计算及服务器厂商供应链，广泛应用于国产 AI 算力基础设施。

公司最新一代 CXL 芯片作为国内首颗获得国际颗粒原厂合同的数据存储主控芯片，满足算力直连存储最新需求，预计将协同 GPU 共同驱动尖端 AI 应用场景，如人工智能推理训练一体机等，通过 GPU 直连架构、CXL 高速互连等前沿技术，与国内外 GPU 大厂深度协同，为人工智能算力中心提供高带宽、低延迟

的存算一体解决方案。未来随着国产 GPU 在算力性能上的持续突破，公司将通过持续迭代的存算一体解决方案，带动国产 AI 基础设施实现跨越式发展。

在 AI 驱动的数字经济发展中，算力是数据处理的引擎，而存力则是数据可持续供给的基石，在大模型训练、实时推理等场景中，存力的带宽、延迟与可靠性直接决定了算力的实际效率上限。固态硬盘作为关键存储设备，是现代数字经济高效运转及 AI 产业快速发展的基础，其组成主要包括主控芯片、固件和存储介质（NAND 闪存颗粒和 DRAM）。其中主控芯片相当于固态硬盘的“算力与算法核心”，负责与整机进行数据通信以及闪存颗粒数据管理，是闪存颗粒快速商业化落地的关键因素。

公司是以完整自研高性能数据存储主控芯片技术与产品为基础，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘的半导体存储解决方案提供商。国产颗粒适配方面，通过深度优化算法与芯片内设计，公司数据存储主控芯片对国产闪存颗粒具备业界领先的适配与性能调优能力；产业链方面，公司作为国内极少数具备企业级主控芯片及固态硬盘完整迭代研发能力的企业，助力我国半导体存储行业构建起从主控芯片、固件实现到存储模组的完整国产化链条；产品迭代方面，公司芯片及固态硬盘产品覆盖 SATA 到 PCIe 5.0，最新一代 PCIe 6.0 主控芯片和 CXL 主控芯片已于 2026 年上半年流片，产品代次发布国内领先，技术水平位居国际第一梯队。

公司拥有良好的声誉及稳定广阔的客户群体，已进入行业头部客户的供应链体系，产品广泛应用于下游技术要求最高的企业级客户与知名消费级客户，并实现规模出货，包括客户 A、联想、新华三、客户 C、长江计算、超云、长城等国内头部服务器厂商，客户 B、Bilibili、腾讯等互联网及云计算厂商，客户 E、闪迪、威刚科技、佰维存储、江波龙等国际颗粒原厂及存储模组厂商，终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。

公司自成立以来不断拓展营销渠道，除境内的优质客户外，公司与国际客户建立了密切、稳定的合作关系，下游知名国际客户包括客户 E、威刚科技（全球第二大存储模组厂商）、闪迪（全球闪存存储解决方案领导者之一，分拆自西部数据）、TDK（全球领先的电子元件、传感器及电源解决方案提供商）、Swissbit（欧洲最大的独立嵌入式存储器和存储解决方案供应商）等。

公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业，并承担上海市战略性新兴产业重大项目。此外，公司凭借领先的产品与服务积累了良好的声誉，成为“2025年中国IC设计Fabless100排行榜——TOP10存储器公司”中唯一全部采用自研数据存储主控芯片的企业，连续5年获评中国电子信息产业发展研究院颁布的“中国芯”存储芯片领域奖项，包括“优秀技术创新产品”和“优秀市场表现产品”奖项；连续3年获得“胡润全球瞪羚企业”等荣誉。根据Frost&Sullivan统计，在2024年中国固态硬盘市场中，公司在全部采用自研主控芯片的境内固态硬盘厂商中排名第一。

### （三）核心技术情况

公司通过自主研发的方式形成了具备较强行业竞争力的核心技术体系，在各系列主要产品中发挥了重要作用，截至本上市保荐书签署日，公司的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
<b>一、芯片设计、固件与算法技术</b>			
1	超强纠错编解码技术	自主研发	包括先进的低密度奇偶校验码（LDPC码）、高效的编解码算法架构、超短延时的BCH编解码引擎等一系列ECC算法、固件框架以及一系列对应的芯片内加速器IP。该技术在极大提高数据容错性和固态硬盘使用寿命的同时，增加系统的吞吐量并有效的控制系统功耗和成本。
2	灵活配置的地址映射技术	自主研发	该技术支持动态配置地址映射大小和无DDR地址映射，解决大容量固态硬盘的L2P映射表的额外的存储消耗和转换过程中的地址空间浪费，使得在有限的DRAM的资源下实现更大容量，从而提升存储主控芯片可支持的最大容量。
3	融合CPU IP和加速器IP的多核低功耗架构	自主研发	在存储主控芯片设计中使用业内主流的ARM处理器架构，并且在PCIe 5.0主控芯片设计中采用RISC-V处理器架构，通过处理器核与多个加速器IP之间，以及处理器核与核之间的高速通信与协同工作，以较低功耗实现高算力，保证存储设备拥有更好性能、更低功耗和更高可靠性，并推进RISC-V架构在存储领域的应用落地。
4	增强型HMB设计	自主研发	增强型HMB（Host Memory Buffer）技术依靠主控芯片内的固件与对应的加速器IP共同合作，直接调用主系统内存，使得固态硬盘无需再具备专用的缓存芯片，节省成本的同时仍能够保证产品性能。
5	融合CXL协议和闪存控制的技术	自主研发	CXL协议扩展了主机和存储子系统进行通信的距离，允许主机跨越更远距离与存储目标进行通信，同时保持超低延时。公司开发的结合CXL和闪存的技术为主机提供了大容量、低延时的内存扩展方案。

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
<b>二、颗粒适配与加速技术</b>			
1	软硬件结合的颗粒适配与加速技术	自主研发	公司全系列产品均支持并行多个 NAND 通道，通过 ONFI 和 Toggle 等接口支持 SLC（单层单元）、MLC（多层单元）、TLC（三层单元）和 QLC（四层单元）的 NAND 闪存颗粒。已完成多款 NAND 闪存适配，覆盖业界主流 NAND。
2	NAND 错误控制技术	自主研发	NAND 错误控制技术包括一系列具体技术以及在对应的一系列加速器 IP 内的实现，错误控制技术与 ECC 纠错技术互相配合，共同确保固态硬盘数据的可靠性与完整性。
3	超高速与混合自适应的闪存接口技术	自主研发	通过芯片内固件与闪存控制器 IP 的合作对闪存进行读写训练，从而找到每个闪存通道能够运行的最高速率，实现系统性能的最优化。
4	新一代高性能低延时 SCM 颗粒的适配与加速技术	自主研发	通过主控芯片内超短延时队列流水线、芯片内 CPU 核上固件算法以及可动态调度的颗粒指令序列设计，综合提高新一代 SCM 颗粒的可用寿命、读写带宽与数据吞吐性能。
<b>三、企业与数据中心固态硬盘技术</b>			
1	端到端数据保护技术	自主研发	端到端数据保护技术支持各种类型 CRC 和 memoryECC 对数据链路进行保护，并利用一系列芯片内加速器 IP 的相应子功能进行加速，除此以外，并引入内部 PI 的机制，确保数据在每一个传输环节的完整性。
2	数据安全引擎技术	自主研发	数据加密算法及其芯片内对应 IP 全面支持国家密码管理局审定批准的多种加密算法，并创新性的提供灵活高效的权限管理与分区加密功能，为用户认证和数据安全提供强有力保护。
3	高速 DDR 接口控制器	自主研发	公司高速 DDR 控制器 IP 支持多端口以及多种 ECC 模式，具有更高的预读取、更高的突发长度和更高的并行能力。
4	DDR 环回测试技术	自主研发	DDR 环回测试技术配合高速 DDR 接口控制器，通过多路复用和流程控制等技术，实现针对 DDR 控制器电子电路的环回测试方案，高效验证芯片的输入输出（IO）端口功能是否正常。
5	地址映射加速器技术	自主研发	L2P 地址映射加速器技术利用芯片内加速器 IP 来处理复杂的地址转化计算、快速查找有效存储单元、记录磨损周期并提供比较结果，保证大容量固态硬盘在系统中的可靠性和耐用性。
6	数据智能管理与压缩技术	自主研发	采取去重算法以及压缩算法，消除冗余数据，减少垃圾数据的收集，提升存储设备的使用效率和性能，同时对敏感数据提供符合用户特色的安全保护方式。
7	动态低功耗技术	自主研发	动态低功耗技术依靠芯片内一系列加速器与控制器 IP 内的相关功能，使得固件通过监控系统传输速率，灵活决定电源精细化管理状态，具有更低的进出延迟，同时又达到节省功耗的效果。
8	智能温控与高级电源管理技术	自主研发	智能控温与高级电源管理技术在固态硬盘的温度升高到可能对其造成损害时，自动减慢或限制固态硬盘的性能以降低温度并确保其安全运行，同时通过管理和优化固态硬盘的电源消耗，整体上降低固态硬盘功耗，延长寿命，并在需要时提供快速的响应。

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
9	固件安全启动技术与在线固件安全升级技术	自主研发	用于保护固态硬盘固件启动加载，防止未经授权的固件修改。
10	其他企业级模组技术	自主研发	通过企业级模组内部部件的键合设计、拓扑设计、信号完整性设计、热导设计等，为企业级模组高性能、低功耗与热管理的综合特性提供技术基础。
11	AI SSD 模组与硬件子系统综合设计	自主研发	通过综合设计模组内并行队列与子系统队列的流水线与调度算法以及优化接口协议，提高 AI 存储系统的使用寿命、性能与功耗表现。

#### （四）发行人的研发水平

公司注重自主研发，且始终保持着较高的研发投入。报告期内，公司研发投入分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元，占当期营业收入的比重分别为 93.20%、48.82% 和 25.76%。

报告期各期末，公司研发人员人数及占比情况如下：

单位：人

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
研发人员	198	187	203
总人数	308	296	298
研发人员占比	64.29%	63.18%	68.12%

截至报告期期末，公司共有 198 名研发人员，其中博士 3 名，硕士 101 名，超过 50% 的研发人员具备硕士及以上学历。

公司高度重视优秀人才的引进和培养，将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源。公司自成立以来建立了完善的人才招聘、培养和激励制度，聘用了大量行业知名专业人员，建立了一支卓越的全球化研发团队，并通过人才培养和人才梯队建设，为公司的可持续化发展提供人员保障。

#### （五）主要财务数据及指标

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额（万元）	183,392.93	108,450.87	107,098.78
归属于母公司所有者权益（万元）	68,979.49	8,004.45	51,154.94
资产负债率（合并）	62.39%	92.62%	52.24%

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
资产负债率（母公司）	55.36%	75.39%	42.20%
营业收入（万元）	103,418.31	62,496.77	35,777.31
净利润（万元）	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-47,028.70	-53,982.82	-36,569.22
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-48,792.55	-54,763.89	-37,448.10
基本每股收益（元/股）	-1.22	-1.50	-1.38
稀释每股收益（元/股）	-1.22	-1.50	-1.38
加权平均净资产收益率	-197.04%	-171.39%	-183.44%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-65,280.38	-85,172.22	-37,519.90
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	25.76%	48.82%	93.20%

## （六）发行人存在的主要风险

### 1、与发行人相关的风险

#### （1）尚未盈利且存在累计未弥补亏损风险

报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-36,569.22 万元、-53,982.82 万元、-47,028.70 万元，尚未实现盈利，截至 2025 年末，公司未弥补亏损为-127,926.22 万元，预计短期内无法进行利润分配，对投资者的投资收益造成一定影响。报告期内，公司亏损的主要原因系公司为保持技术先进性持续进行大额研发投入、企业级固态硬盘业务尚处于发展阶段、存储行业周期波动导致存货跌价计提金额较大和确认大额股份支付费用所致。若公司未来遭遇存储行业下行周期盈利空间被压缩、市场竞争激烈产品销售价格不及预期，则公司面临未来一定期间无法实现盈利的风险。

#### （2）毛利率波动风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 33.09%、10.92%和 5.29%，主要系公司产品线由主控芯片延伸至消费级及企业级固态硬盘，主营业务产品结构发生变动，且报告期内企业级固态硬盘处于市场拓展与导入验证期所致。此外，2025

年下半年以来，因 AI 服务器需求爆发导致存储市场供需失衡，带动 DRAM 等主要原材料价格发生较大波动。报告期内，公司把握存储行业国产替代、自主可控趋势，不断提升主控芯片与国产颗粒适配性，与国产颗粒厂商建立了深度合作关系，提升了自身供应链的稳定性。但未来公司若不能有效控制产品成本、提升自身议价能力或行业供需状况发生较大变化，公司毛利率水平将存在一定波动风险。

### （3）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,569.64 万元、39,593.44 万元和 68,643.80 万元，主要由原材料、产成品和合同履约成本构成。公司根据下游市场需求及主要原材料价格变动趋势管控存货规模。报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 4,840.39 万元、18,464.97 万元和 18,483.00 万元，其中包括合同履约成本跌价准备 0.00 万元、7,342.20 万元及 7,189.50 万元。公司已根据相关存货及合同履约成本的可变现净值预计可回收金额谨慎计提存货跌价准备。未来如出现产品销售价格大幅下跌、主要原材料价格剧烈波动、旧代际存量产品销售周转放缓或合同履约进度不及预期等情况，公司将面临一定存货跌价损失的风险。

### （4）技术和产品迭代风险

公司所处的存储行业及其细分的数据存储主控芯片和固态硬盘行业以技术创新为核心驱动力。近年来，随着主控芯片接口速度、闪存颗粒、工艺制程的快速演进，公司的技术路线及下游市场需求持续处于快速发展和迭代的状态。如果公司未来不能准确判断行业发展趋势、技术演变方向及下游市场需求，则可能导致公司技术及产品竞争力下降，存在业绩增速放缓或下滑的风险。

### （5）研发人员流失及技术泄密风险

公司的核心竞争力来源于优秀的研发团队。经过多年的发展，公司已组建了一支覆盖芯片设计、固件与算法技术、颗粒适配与加速技术和企业与数据中心固态硬盘技术等多项核心技术的专业研发团队。为确保核心技术的安全性，公司高度重视对员工保密意识的培养，并通过与相关人员签署保密协议，严控机密外泄风险，同时也通过合理的薪酬制度和股权激励，确保研发团队的稳定。然而，由于国内相关领域的人才缺口大，市场竞争激烈，仍可能存在核心研发人员流失及核心技术泄密的风险，进而可能影响公司的核心竞争力。

#### （6）客户集中度较高及主要客户变化风险

报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为 78.96%、57.00% 和 69.83%，在报告期存在客户集中度较高的情况，主要系公司仍处于业务规模扩张阶段，优先与各应用领域的少数头部客户建立合作关系，对同一客户的销售规模受到客户采购计划、市场竞争状况、产品代际更迭和价格波动等因素影响，不同年度销售规模不同。报告期内，公司逐步丰富业务结构，产品条线由主控芯片延伸至消费级及企业级固态硬盘，导致公司报告期各期前五名客户构成存在一定变化。公司若未来不能稳定开拓客源，可能存在公司经营业绩不稳定的风险。

#### （7）供应商集中度较高风险

报告期内，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 68.36%、56.57% 和 70.09%。公司对外采购原材料主要为晶圆、NAND 闪存颗粒、DRAM 等，对外采购服务主要为自研主控芯片封装、测试服务和企业级 SSD 委托组装。由于半导体存储领域具有较高的资本技术壁垒和市场集中度，能够满足公司业务需求和技术要求的优质合作方较少，因此公司供应商集中度较高。如果未来出现全球贸易政策限制或产能分配变化、公司主要供应商出现发展经营不善等情形，影响与公司合作，将对公司正常经营造成不利影响。

#### （8）应收账款回收风险

报告期各期末，应收账款余额分别为 15,472.34 万元、40,978.66 万元和 56,366.04 万元，应收账款余额占当期营业收入比例分别 43.25%、65.57% 和 54.50%。报告期内，随着公司业务规模快速发展，应收账款也随之增长，公司已谨慎计提了坏账准备。未来如宏观经济、客户经营情况等发生不利变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，公司的资金周转和经营性活动现金流将受到不利影响。

#### （9）经营性现金流净额为负及流动性风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-37,519.90 万元、-85,172.22 万元和-65,280.38 万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要系：（1）报告期内公司处于尚未盈利阶段。公司为提升产品竞争力，持续保持高强度研发投入，经营活动流入现金尚无法全部覆盖各项成本费用支出；（2）报告期内因销售规模持续扩大及主要原材料价格波动，公司进行合理

备货，故购买商品、接受劳务支付的现金较多。未来公司将继续进行较大金额的研发投入以及其他必要的经营相关资金支出，故存在未来一段时间内公司经营活动现金流持续为负的可能性。若公司外部融资渠道受限时，将会对公司的现金流造成压力，从而对公司研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面造成不利影响。

#### （10）募投项目未能顺利实施或效益不达预期的风险

公司本次募集资金主要用于新一代数据中心企业级存储系统方案研发及产业化项目和面向 AI 领域存储系统方案研发项目。公司已基于当前的行业状况、技术发展现状等情况对相关募投项目的必要性和可行性进行了充分论证。但是在项目实施过程中，如果公司无法实现关键技术的突破、产品性能未达设计目标或者市场环境出现较大变化，则募投项目可能存在无法顺利实施或效益不达预期的风险，对公司的业绩产生一定影响。

#### （11）实际控制人持股比例较低的风险

截至报告期末，本次发行前，公司整体股权结构较为分散，公司实际控制人 ZINING WU 的持股比例较低，其通过开曼英韧控制公司 13.90%表决权、通过上海韧存控制公司 11.89%表决权，合计控制公司 25.78%表决权。本次发行后实际控制人的持股比例将进一步降低，如果未来公司股权发生重大变动导致公司的实际控制权发生变更，可能对公司经营管理产生不利影响。

## 2、与行业相关的风险

### （1）行业周期性波动风险

公司所处行业下游终端需求受宏观经济、技术发展、产能状况等因素影响呈现周期性变化，导致下游 AI、云计算、互联网等行业客户调整其对存储产品在内的信息基础设施资本开支。此外，受宏观经济周期、上下游技术进步及存储颗粒厂产能扩张计划等因素影响，NAND 闪存颗粒和 DRAM 市场呈现一定周期性波动的特征。如未来因存储颗粒厂产能变化、下游需求低迷等因素导致市场增长不如预期，则可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

### （2）市场竞争风险

近年来,随着中国对半导体存储产业的大力支持和国内企业技术实力的不断增强,国内厂商的市场份额处于快速增长阶段,市场竞争也日趋激烈。公司拥有自研主控芯片和固件算法,作为国产品牌代表厂商,同时面临全球行业龙头厂商和国内其他厂商的市场竞争。若市场竞争态势进一步加剧,公司行业地位和市场份额将受到国内外竞争对手冲击,进而对公司经营业绩产生不利影响。

## 二、申请上市股票的发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次拟发行股份不低于47,806,826股,占发行后总股本的比例不低于10%（行使超额配售选择权之前,最终以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份
每股发行价格	【】元
发行方式	采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用证券监管部门认可的其他发行方式
发行对象	符合规定资格的询价对象和在上交所开立账户并已开通科创板市场交易账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所科创板

## 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

国泰海通指定陈健、任飞为英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人;指定林韬为项目协办人;指定周浩天、李凯、李嘉琪、唐世良、杨周平、李冬、朱大春为项目组成员。

### （一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

陈健先生:本项目保荐代表人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施,最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

任飞先生:本项目保荐代表人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施,最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

## （二）项目协办人保荐业务主要执业情况

本保荐人指定林韬为本次发行的项目协办人。

林韬先生：本项目协办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

## （三）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：周浩天、李凯、李嘉琪、唐世良、杨周平、李冬、朱大春。

## （四）本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员自愿接受上海证券交易所自律监管的承诺

本次证券发行上市的保荐代表人陈健和任飞、协办人林韬及项目组其他成员自愿接受上海证券交易所自律监管的承诺如下：

“本人将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受上海证券交易所的自律监管措施。”

## 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责的情形的说明

### （一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通全资子公司国泰君安证裕投资有限公司拟参与本次发行战略配售。

截至本上市保荐书签署日，国泰海通的全资子公司国泰君安证裕直接持有发行人 0.27% 的股份，国泰海通的控股股东上海国际集团有限公司的全资子公司国鑫投资直接持有发行人 1.60% 的股份。此外，国泰海通及其控股股东上海国际集团有限公司存在因投资其他机构导致被动间接持有发行人股份的情况，间接持股比例合计不超过 1%。

除上述情况外，不存在保荐人或其控股股东、重要关联方持有或者通过参与

本次战略配售持有发行人或其重要关联方股份的情况。

## **（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况**

截至本上市保荐书签署日，发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

## **（三）保荐人与发行人之间的其他关联关系**

截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，保荐人的董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况。

## **（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况**

截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

## **（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系**

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

## **五、保荐人承诺事项**

**（一）本保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其发起人、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序**

保荐人同意推荐英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

**（二）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条的规定，国泰海通作出如下承诺**

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受上海证券交易所的自律监管；

9、中国证监会、上海证券交易所规定的其他事项。

## 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

### （一）董事会决策程序

2026年1月21日，发行人召开了第一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

### （二）股东会决策程序

2026年1月27日，发行人召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等与本次发行上市有关的议案。

综上，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

### （三）保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：上述董事会、股东会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均合法、有效。发行人本次发行已经依其进行阶段，取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权，授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

## 七、保荐人关于发行人符合科创板定位的核查意见

### （一）发行人符合科创板支持方向的核查情况

#### 1、发行人符合国家科技创新战略情况

集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。政府自 2000 年以来将集成电路行业确定为国民经济支柱性行业之一，并先后出台了一系列针对集成电路行业的产业政策，推动了行业的迅速发展。近年来，集成电路行业主要的法律法规及政策列表如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
1	2026 年	全国人大常委会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	统筹布局、有序建设算力设施，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展。加快国家枢纽算力设施集群建设，支持有条件地区根据低时延场景需求适度发展算力，推进云边端协同发展。加强高性能高质量智算资源供给，论证建设超大规模智算集群
2	2024 年	中共中央	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展和治理体系；抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用
3	2024 年	工信部	《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》	深入推进 5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局 6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施
4	2024 年	网信办、市监局、工信	《信息化标准建设行动	建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系……围绕集成电路关键领域，加

序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
		部	计划 (2024-2027年)》	大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关,推进人工智能芯片、车用芯片.....等应用标准研制
5	2023年	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	集成电路设计,集成电路线宽小于65纳米(含)的逻辑电路、存储器生产,线宽小于0.25微米(含)的特色工艺集成电路生产(含掩模版、8英寸及以上硅片生产),集成电路线宽小于0.5微米(含)的化合物集成电路生产,和球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)、栅格阵列封装(LGA)、系统级封装(SIP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)、传感器封装(MEMS)、2.5D、3D等一种或多种技术集成的先进封装与测试,集成电路装备及关键零部件制造
6	2023年	工业和信息化部等六部门	《算力基础设施高质量发展行动计划》	加速存力技术研发应用。围绕全闪存、蓝光存储、硬件高密、数据缩减、编码算法、芯片卸载、多协议数据互通等技术,推动先进存储创新发展。鼓励先进存储技术的部署应用,实现存储闪存化升级,进一步提升我国全闪存技术竞争力并持续提升存储产业能力。鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平,打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应用相互促进、协同发展的产业生态

综上,公司技术产品符合国家高新技术产业和战略性新兴产业规划、政策。

## 2、发行人拥有关键核心技术等先进技术或产品情况

### (1) 核心技术情况

公司通过自主研发的方式形成了具备较强行业竞争力的核心技术体系,在各系列主要产品中发挥了重要作用。截至本上市保荐书签署日,公司的核心技术情况如下:

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
<b>一、芯片设计、固件与算法技术</b>			
1	超强纠错编解码技术	自主研发	包括先进的低密度奇偶校验码(LDPC码)、高效的编解码算法架构、超短延时的BCH编解码引擎等一系列ECC算法、固件框架以及一系列对应的芯片内加速器IP。该技术在极大提高数据容错性和固态硬盘使用寿命的同时,增加系统的吞吐量并有效的控制系统功耗和成本。
2	灵活配置的地址映射技术	自主研发	该技术支持动态配置地址映射大小和无DDR地址映射,解决大容量固态硬盘的L2P映射表的额外的存储消耗和

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
			转换过程中的地址空间浪费，使得在有限的 DRAM 的资源下实现更大容量，从而提升存储主控芯片可支持的最大容量。
3	融合 CPU IP 和加速器 IP 的多核低功耗架构	自主研发	在存储主控芯片设计中使用业内主流的 ARM 处理器架构，并且在 PCIe 5.0 主控芯片设计中采用 RISC-V 处理器架构，通过处理器核与多个加速器 IP 之间，以及处理器核与核之间的高速通信与协同工作，以较低功耗实现高算力，保证存储设备拥有更好性能、更低功耗和更高可靠性，并推进 RISC-V 架构在存储领域的应用落地。
4	增强型 HMB 设计	自主研发	增强型 HMB (Host Memory Buffer) 技术依靠主控芯片内的固件与对应的加速器 IP 共同合作，直接调用主系统内存，使得固态硬盘无需再具备专用的缓存芯片，节省成本的同时仍能够保证产品性能。
5	融合 CXL 协议和闪存控制的技术	自主研发	CXL 协议扩展了主机和存储子系统进行通信的距离，允许主机跨越更远距离与存储目标进行通信，同时保持超低延时。公司开发的结合 CXL 和闪存的技术为主机提供了大容量、低延时的内存扩展方案。
<b>二、颗粒适配与加速技术</b>			
1	软硬件结合的颗粒适配与加速技术	自主研发	公司全系列产品均支持并行多个 NAND 通道，通过 ONFI 和 Toggle 等接口支持 SLC (单层单元)、MLC (多层单元)、TLC (三层单元) 和 QLC (四层单元) 的 NAND 闪存颗粒。已完成多款 NAND 闪存适配，覆盖业界主流 NAND。
2	NAND 错误控制技术	自主研发	NAND 错误控制技术包括一系列具体技术以及在对应的一系列加速器 IP 内的实现，错误控制技术与 ECC 纠错技术互相配合，共同确保固态硬盘数据的可靠性与完整性。
3	超高速与混合自适应的闪存接口技术	自主研发	通过芯片内固件与闪存控制器 IP 的合作对闪存进行读写训练，从而找到每个闪存通道能够运行的最高速率，实现系统性能的最优化。
4	新一代高性能低延时 SCM 颗粒的适配与加速技术	自主研发	通过主控芯片内超短延时队列流水线、芯片内 CPU 核上固件算法以及可动态调度的颗粒指令序列设计，综合提高新一代 SCM 颗粒的可用寿命、读写带宽与数据吞吐性能。
<b>三、企业与数据中心固态硬盘技术</b>			
1	端到端数据保护技术	自主研发	端到端数据保护技术支持各种类型 CRC 和 memoryECC 对数据链路进行保护，并利用一系列芯片内加速器 IP 的相应子功能进行加速，除此以外，并引入内部 PI 的机制，确保数据在每一个传输环节的完整性。
2	数据安全引擎技术	自主研发	数据加密算法及其芯片内对应 IP 全面支持国家密码管理局审定批准的多种加密算法，并创新性的提供灵活高效的权限管理与分区加密功能，为用户认证和数据安全提供强有力保护。
3	高速 DDR 接口控制器	自主研发	公司高速 DDR 控制器 IP 支持多端口以及多种 ECC 模式，具有更高的预读取、更高的突发长度和更高的并行能力。
4	DDR 环回测试技术	自主研发	DDR 环回测试技术配合高速 DDR 接口控制器，通过多路复用和流程控制等技术，实现针对 DDR 控制器电子电路的环回测试方案，高效验证芯片的输入输出 (IO) 端口功

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
			能是否正常。
5	地址映射加速器技术	自主研发	L2P 地址映射加速器技术利用芯片内加速器 IP 来处理复杂的地址转化计算、快速查找有效存储单元、记录磨损周期并提供比较结果，保证大容量固态硬盘在系统中的可靠性和耐用性。
6	数据智能管理与压缩技术	自主研发	采取去重算法以及压缩算法，消除冗余数据，减少垃圾数据的收集，提升存储设备的使用效率和性能，同时对敏感数据提供符合用户特色的安全保护方式。
7	动态低功耗技术	自主研发	动态低功耗技术依靠芯片内一系列加速器与控制器 IP 内的相关功能，使得固件通过监控系统传输速率，灵活决定电源精细化管理状态，具有更低的进出延迟，同时又达到节省功耗的效果。
8	智能温控与高级电源管理技术	自主研发	智能控温与高级电源管理技术在固态硬盘的温度升高到可能对其造成损害时，自动减慢或限制固态硬盘的性能以降低温度并确保其安全运行，同时通过管理和优化固态硬盘的电源消耗，整体上降低固态硬盘功耗，延长寿命，并在需要时提供快速的响应。
9	固件安全启动技术与在线固件安全升级技术	自主研发	用于保护固态硬盘固件启动加载，防止未经授权的固件修改。
10	其他企业级模组技术	自主研发	通过企业级模组内部部件的键合设计、拓扑设计、信号完整性设计、热导设计等，为企业级模组高性能、低功耗与热管理的综合特性提供技术基础。
11	AI SSD 模组与硬件子系统综合设计	自主研发	通过综合设计模组内并行队列与子系统队列的流水线与调度算法以及优化接口协议，提高 AI 存储系统的使用寿命、性能与功耗表现。

(2) 公司各类技术产品所在产业链及在其中的位置、在相关细分领域国际和国内发展中的位置

固态硬盘组成主要包括主控芯片、固件和存储介质（NAND 闪存颗粒和 DRAM）。其中，主控芯片与固件协同工作，共同实现了包括坏块管理、纠错校验、磨损均衡、垃圾回收等关键功能，直接决定了固态硬盘在性能、稳定性、数据安全及使用寿命等方面的综合表现，广泛应用于服务器、消费电子、工业控制等领域。

公司凭借对存储接口及协议的全面覆盖与深刻理解，从 SATA 到 PCIe 5.0 以及研发中的 PCIe 6.0，构建了可扩展、可迭代的统一芯片架构平台，使得同一代自主研发主控芯片能够通过固件配置，灵活适配不同品牌（包括三星、铠侠、闪迪、SK 海力士等）的闪存颗粒。通过持续的产品迭代，公司不断优化主控芯片的并发处理能

力、颗粒指令调度及功耗管理，从而能够充分挖掘并释放各类厂商颗粒的潜在性能。无论是面向高速数据处理的 PCIe 接口，还是注重成本效益的 SATA 接口，公司均能通过精准的固件调优，实现颗粒性能的最大化利用，为客户提供从消费级到企业级、从通用计算到 AI 计算的全场景、全代次、高性能、高性价比存储产品矩阵。

实现存储产品的全国产化，核心难点在于打通“核心算法芯片加速-固件适配客户需求-闪存调优平台化”这一完整技术链，并实现深度融合。具体而言，NAND 闪存颗粒在原始误码率、读写延迟一致性、耐久性等底层物理特性上与整机需求存在客观差距。公司凭借芯片完整自研优势，针对各种颗粒特性进行了芯片架构与算法加速的深度优化，将基于国产颗粒的固态硬盘误码率显著降低多个数量级，有效延长颗粒使用寿命，使其在关键性能与可靠性指标上实现对国际主流厂商产品的对标与赶超，为下游客户在关键信息基础设施领域提供了高性能、高安全、自主可控的存储解决方案。

公司始终坚持国产化替代与国际化拓展双轨并行发展，自研主控芯片及固态硬盘产品已获得国内外客户的广泛验证与采用。公司技术实力与产品性能位居国际第一梯队，深度融合并引领全球存储产业前沿演进趋势，积极布局 PCIe 6.0/7.0、CXL 等下一代接口技术，并与国际颗粒原厂开展合作，确保其产品迭代与全球产业升级同步。CXL 是一种构建在 PCIe 物理层之上的高速互联开放标准，其核心价值在于通过硬件级缓存一致性协议，实现 CPU 与 GPU、FPGA 等加速器及内存扩展设备之间的高效、低延迟互联与资源共享。在 AI 算力需求爆发的背景下，传统以 CPU 为中心的存储架构已出现性能瓶颈，而 CXL 通过支持内存语义访问和资源池化，能够有效突破“内存墙”限制，为高性能异构计算提供关键基础设施支撑，是未来存储产业升级的关键技术方向。

随着 GPU 等 AI 算力对存储系统的要求持续演进，以英伟达为代表的 GPU 厂商正不断推动基于 PCIe 6.0 的 GPU 直连存储系统解决方案落地。为此，国际颗粒原厂已迅速推动 PCIe 6.0/7.0 AI SSD（算力直连高性能固态硬盘）的技术研究与产品开发。铠侠于 2025 年明确了其 AI SSD 的发展路径：在行业普遍实现 PCIe 5.0 约 300 万 IOPS 的基础上，于 2026 年底依托 PCIe 6.0 主控芯片率先达成 1,000 万 IOPS，并计划在 2027 年结合 PCIe 7.0 主控芯片进一步提升至 1 亿 IOPS。

结合与客户 E 的合作情况，公司最新一代 PCIe 6.0 芯片和 CXL 芯片将能够较

好满足国内外人工智能市场需求。在 AI 算力中心的推动下，AI SSD 将进入技术快速演进与规模化商用关键阶段。

(3) 公司核心技术产品与国际国内可比公司同类技术产品技术指标、功能性差异比较

公司数据存储主控芯片和固态硬盘已实现从 SATA 到 PCIe 5.0 的主流代次全覆盖，以及企业级、消费级、工业级的应用领域全覆盖，公司主要产品与同行业公司产品的对比情况如下：

#### ①数据存储主控芯片

##### A. 消费级 PCIe 4.0 固态硬盘主控芯片

项目	发行人	联芸科技	慧荣科技	群联电子
型号	IG5222	MAP1602-C	SM2268XT2	PS5029-E29T
适配闪存类型	SLC/MLC/TLC/QLC	MLC/TLC/QLC	未披露	TLC/QLC
顺序读取速度 (MB/s)	7,400	7,400	7,400	7,400
顺序写入速度 (MB/s)	6,800	6,500	6,700	6,600
随机读取速度 (K IOPs)	1,200	1,000	1,200	1,000
随机写入速度 (K IOPs)	1,200	1,000	1,200	1,400

注：顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度数值越大越好，下同。

公司自研消费级 PCIe 4.0 主控芯片 IG5222 具有高性能、低功耗、较小芯片面积的产品特性，相较于同行竞品，在各项核心指标方面均对标行业最高水平。

##### B. 企业级 PCIe 4.0 固态硬盘主控芯片

项目	发行人	FADU	慧荣科技
型号	IG5638	FC4121	8266
适配闪存类型	SLC/MLC/TLC/QLC	未披露	未披露
顺序读取速度 (MB/s)	7,400	7,050	6,500
顺序写入速度 (MB/s)	7,000	4,200	3,500
随机读取速度 (K IOPs)	1,700	1,350	900
随机写入速度 (K IOPs)	900	390	200

项目	发行人	FADU	慧荣科技
随机写入延迟 (μs)	9	未披露	15

注：随机写入延迟为企业级固态硬盘主控芯片核心指标之一，数值越小越好，下同。

公司自研企业级 PCIe 4.0 主控芯片 IG5638 具备高性能、低延时的产品特性，适用于数据中心、云计算、AI 等下游应用。相较于同行竞品，IG5638 在各项核心指标方面均具备显著优势。

### C. 企业级 PCIe 5.0 固态硬盘主控芯片

项目	发行人	平头哥	FADU	Marvell	慧荣科技
型号	YRS900	镇岳 510	FC5161	MV-SS1331/SS1333	SM8366
适配闪存类型	SLC/MLC/TLC/QLC	TLC/QLC	TLC	SLC/MLC/TLC/QLC	TLC/QLC
顺序读取速度 (MB/s)	14,700	14,000	14,000	14,000	14,200
顺序写入速度 (MB/s)	12,000	10,000	12,000	9,000	9,400
随机读取速度 (K IOPS)	3,500	3,400	3,500	2,000	3,500
随机写入速度 (K IOPS)	2,500	2,500	1,600	1,000	2,800
随机写入延迟 (μs)	4	<4	10	<6	9

公司自研企业级 PCIe 5.0 主控芯片 YRS900 在顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度、随机写入延迟等核心指标方面均优于或与同行业公司主流产品持平。

## ②固态硬盘

### A. 企业级 PCIe 4.0 固态硬盘

项目	发行人	大普微	忆联信息	忆恒创源	三星电子	Solidigm
型号	Dongting-N2 2000	R5100	UH811a	PBlaze6 6930	PM1733	D7-P5520
可用容量 (TB)	7.68					
顺序读取速度 (MB/s)	7,400	7,400	7,100	6,900	7,500	7,100
顺序写入速度 (MB/s)	6,700	5,500	4,500	7,000	6,000	4,200
随机读取速度 (K IOPs)	1,700	1,750	1,700	1,600	1,700	1,100

项目	发行人	大普微	忆联信息	忆恒创源	三星电子	Solidigm
随机写入速度 (K IOPs)	370	280	210	340	300	220
随机读取延迟 ( $\mu$ s)	55	65	96	69	未披露	75
随机写入延迟 ( $\mu$ s)	9	9	17	9	未披露	15

注：顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度数值越大越好，随机读取延迟、随机写入延迟数值越小越好，下同。

公司企业级 PCIe 4.0 固态硬盘 Dongting-N2 2000 在顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度、随机读取延迟、随机写入延迟等核心指标方面均优于或与同行业公司主流产品持平。

### B. 企业级 PCIe 5.0 固态硬盘

项目	发行人	大普微	忆联信息	忆恒创源	三星电子	Solidigm	华为
型号	Dongting-N3	R6101	UH812a	PBlaze7 7A40	PM1743	D7-PS1010	SP560
可用容量 (TB)	7.68						
顺序读取速度 (MB/s)	14,600	14,500	14,900	14,100	14,000	14,500	14,700
顺序写入速度 (MB/s)	12,400	11,000	10,500	11,200	6,000	10,000	11,200
随机读取速度 (K IOPs)	3,500	3,400	3,500	3,300	2,500	3,000	3,500
随机写入速度 (K IOPs)	620	500	470	500	300	400	600
随机读取延迟 ( $\mu$ s)	52	52	55	55	未披露	60	52
随机写入延迟 ( $\mu$ s)	5	7	7	5	未披露	7	5.4

公司企业级 PCIe 5.0 固态硬盘在顺序读取速度、顺序写入速度、随机读取速度、随机写入速度、随机写入延迟等核心指标方面均优于或与同行业公司主流产品持平。

### C. 高性能 AI SSD

项目	发行人	华为
型号	Dongting-N3X	EX560
接口类型	PCIe 5.0	PCIe 5.0

项目	发行人	华为
可用容量 (TB)	1.6	
顺序读取速度 (MB/s)	14,000	14,900
顺序写入速度 (MB/s)	11,000	12,000
随机读取速度 (K IOPs)	3,500	2,863
随机写入速度 (K IOPs)	1,600	1,500
随机读取延迟 ( $\mu$ s)	18	40
随机写入延迟 ( $\mu$ s)	4	5.4

注：目前行业内除发行人及华为外，暂无其他公司发布高性能 AI SSD 产品。

公司高性能 AI SSD 在随机读取速度、随机写入速度、随机写入延迟等核心指标方面均优于华为主流产品，顺序读取速度、顺序写入速度略低于华为。

### 3、发行人科技创新能力、科技成果转化能力情况

#### (1) 技术应用情况

公司以主控芯片技术为起点，持续推动芯片技术产业化落地，凭借技术迭代与客户服务体系的完善，将业务逐步拓展至企业级固态硬盘。公司完整自研的芯片技术为固态硬盘产品构筑了性能、能效及可靠性核心竞争力，形成底层技术壁垒。通过芯片的持续迭代，公司的固态硬盘产品得以不断突破性能边界，精准适配 AI 驱动的算力中心、云服务的前沿一线场景的极致需求。

同时，规模化发展的固态硬盘业务对芯片研发形成了至关重要的反哺与驱动，在为公司提供持续稳定的现金流，支撑长期高强度研发投入的同时，助力公司直接触达终端客户与复杂应用场景，提高公司对终端市场需求与技术发展方向的洞察能力。终端应用的反馈直接指导了下一代主控芯片的架构定义与功能创新，确保公司技术演进始终与市场变化同频共振。

在此基础上，芯片业务与固态硬盘业务的深度协同，进一步锤炼并提升了公司的系统级解决方案开发能力。公司凭借对芯片到固态硬盘的全链路技术掌控，能够将领先的芯片设计能力与深刻的系统开发理念相结合，为客户提供远超标准组件的高附加值定制化解决方案，从而高效应对不同客户在性能、功耗、可靠性及综合成本等方面的多元化与复杂化挑战，推动存储产业的整体进步。公司具体发展历程如下：



(2) 技术储备情况

截至报告期末，公司正在进行对公司目前及未来经营有重大影响的研发项目如下：

序号	项目名称	拟达到的研发目标	进展情况
1	企业级 PCIe 6.0 智能存储控制器芯片	自研数据存储主控芯片实现 PCIe 6.0 协议的升级；物理层速率达到 64 GT/s，PCIe 6.0x4 双向理论带宽不低于 26 GB/s；支持下一代 CPU 与 GPU 对于 I/O 速度的最新要求。同时，整合了 PCIe 6.0 的物理层协议与 CXL3.0 控制协议的新型产品，可以满足内存扩展和内存池化的要求	开发阶段
2	新一代低功耗消费级存储控制器芯片研发与产业化项目	自研无缓存低功耗 PCIe 4.0x4 存储主控芯片及相关产品的解决方案，为客户提供多种类型的闪存颗粒适配与优化。该产品采用结合硬件加速的无 DRAM 架构，在保持低峰值功耗的同时，可提供 7.4GB/s 和 6.8GB/s 的顺序读写速度	开发阶段
3	基于自研主控的企业级 PCIe 5.0 高性能固态硬盘项目	基于自研 PCIe 5.0 主控芯片，开发搭载多种闪存颗粒的企业级固态硬盘产品线，构建 PCIe 5.0 SSD 高性能产品矩阵。该产品系列顺序读写速度最高可达 14.6GB/s 和 12.4GB/s；随机读写速度可达 3.5M IOPS 和 1.1M IOPS	开发阶段
4	基于自研主控的企业级 PCIe 5.0 超高密度	基于自研 PCIe 5.0 主控芯片，开发搭载多种 QLC 闪存颗粒的企业级固态硬盘产品线，构建	开发阶段

序号	项目名称	拟达到的研发目标	进展情况
	固态硬盘项目	PCIe 5.0 SSD 最高可达 122.88TB 超大容量产品矩阵。该产品顺序读写速度可达 14.5GB/s 和 3.6GB/s; 4KB 随机读取速度可达 2M IOPS、16KB 随机写入速度可达 45K IOPS	
5	基于自研主控的企业级 AI SSD 固态硬盘项目	基于自研 PCIe 5.0 主控芯片, 开发搭载多种 SCM 级闪存颗粒的企业级固态硬盘产品线, 构建 PCIe 5.0 算力直连 AI SSD 产品矩阵。该产品随机读写速度可达 3.5M IOPS 和 1.6M IOPS; 低延时读写能力如 4KB 随机读写延时可缩减至 13us/4us	开发阶段
6	面向下一代存储介质的高带宽超融合智能纠错技术项目	研发满足下一代存储介质在 PCIe 6.0/7.0 和 CXL 3.0/CXL 4.0 带宽需求下的自适应的 ECC 架构, ECC 解码能力可有效降低 CFR 1~2 个数量级, 支持多种存储介质与不同接口产品复用	开发阶段

### (3) 技术创新安排情况

未来, 公司将在加大人才引育力度、提升研发投入强度等方面, 持续提升公司技术创新能力。

加大人才引育力度方面, 公司高度重视优秀人才的引进和培养, 将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源。公司自成立以来建立了完善的人才招聘、培养和激励制度, 聘用了大量行业知名专业人员, 建立了一支卓越的全球化研发团队, 并通过人才培养和人才梯队建设, 为公司的可持续化发展提供人员保障。截至 2025 年末, 公司研发人员数量为 198 人, 占员工总数的比例为 64.29%。公司还通过员工持股计划, 将员工的个人利益与公司的长远利益深度绑定, 提高了员工对公司的认同度, 增强了团队稳定性。

提升研发投入强度方面。报告期内, 公司研发投入分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元, 占当期营业收入的比重分别为 93.20%、48.82% 和 25.76%。未来, 公司将继续坚持核心技术自研的立身之本, 致力于持续突破 PCIe 6.0/7.0、CXL 等前沿接口技术, 并深度优化适配国产闪存颗粒, 构建从芯片设计、固件算法到系统集成的自主可控能力。公司将不断推出全新一代、更高性能的数据存储主控芯片和固态硬盘产品, 补充已有的产品系列和类型, 实现人工智能领域的优先布局, 并根据不断变化的市场需求及产品特点, 形成全新的产品系列类型, 公司产品结构将更加丰富。

### (4) 技术产业化情况

报告期内，公司数据存储主控芯片收入和固态硬盘收入均是公司核心技术产业化形成的收入，总体占比较高，公司核心技术形成的产品和服务与产业实现了深度融合，终端客户触达互联网、云计算、AI 模型训练推理、通信、金融、铁路、能源、教育等各主要细分应用场景。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产业化形成的收入	103,138.17	62,401.86	35,406.12
营业收入	103,418.31	62,496.77	35,777.31
占当期营业收入比例	<b>99.73%</b>	<b>99.85%</b>	<b>98.96%</b>

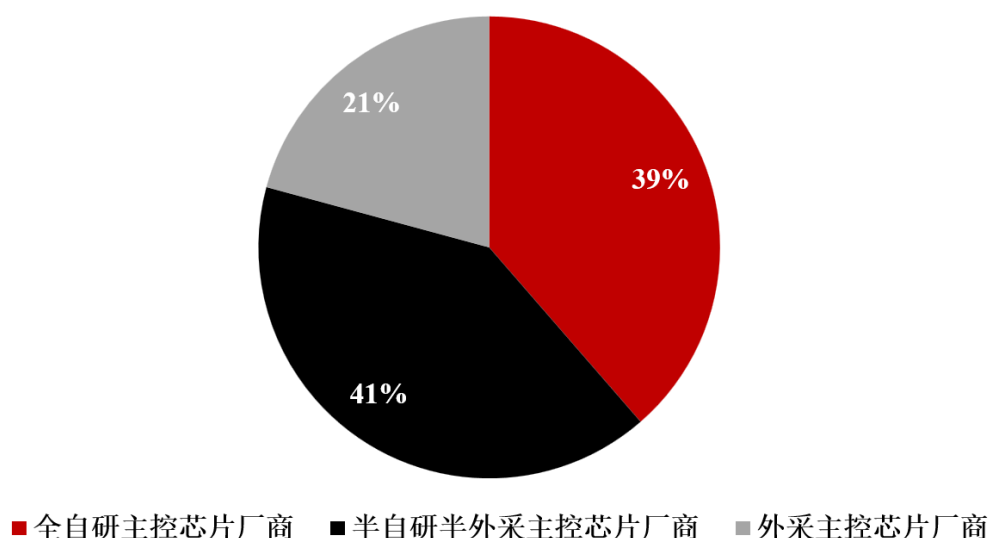
综上，公司具有科技创新能力、科技成果转化能力。

#### 4、行业地位突出，市场认可度高，具有较强成长性

##### (1) 固态硬盘

固态硬盘厂商可以分为全自研主控芯片厂商（如英韧科技）、半自研半外采主控芯片厂商（如大普微）和外采主控芯片厂商（如忆恒创源）。全自研主控芯片厂商一般具备完整的芯片自研能力，依托自主研发的核心技术，提供高性能、高可靠性的主控芯片。由于研发覆盖芯片、固件及模组全流程设计，该类厂商能对产品性能、功耗、可靠性及固件算法进行最深层次的优化，实现软硬件的高度协同，技术上的自主性使得该类厂商能快速响应市场需求，推出新品。根据 Frost&Sullivan 统计，2024 年中国 SSD 市场不同类型厂商的市场份额情况如下：

2024 年中国 SSD 市场不同类型厂商的市场份额

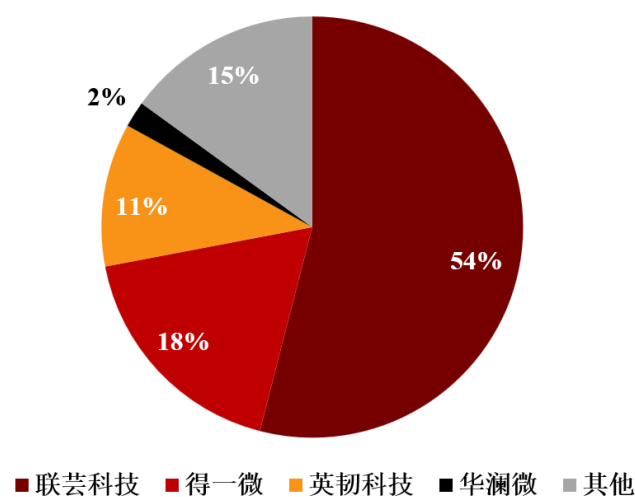


根据 Frost&Sullivan 统计，在 2024 年中国固态硬盘市场中，公司在全部采用自研主控芯片的境内固态硬盘厂商中排名第一。

## （2）固态硬盘主控芯片

固态硬盘主控芯片厂商可以分为 NAND 原厂自研自用固态硬盘主控芯片厂商、非 NAND 原厂自研自用固态硬盘主控芯片厂商、独立固态硬盘主控芯片厂商。根据 Frost&Sullivan 统计，在独立固态硬盘主控芯片市场，2024 年公司销售规模在境内厂商中排名第三，具体情况如下：

### 2024 年境内独立固态硬盘主控芯片厂商竞争格局



数据来源：Frost&Sullivan

因此，公司行业地位突出，市场认可度高，具有较强成长性。

经核查，保荐人认为：发行人主要产品符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，行业地位突出，市场认可度高，具有较强成长性，符合科创板支持方向。

## （二）发行人符合科技创新行业领域的核查情况

公司所属科技创新行业领域见下表：

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主营业务为数据存储主控芯片和固态硬盘（SSD）的研发、设计及销售，完整覆盖企业级、工业级和消费级应用。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“165软件和信息技术服务业”，属于新一代信息技术领域。因此，公司符合科创板行业领域要求。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“165 软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”，符合战略性新兴产业的发展方向。

经核查，保荐人认为发行人满足科创板所属行业领域要求。

### （三）发行人符合科创属性相关指标的核查情况

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》，公司符合科创属性相关评价指标的要求，具体如下：

科创属性相关指标	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000.00 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023-2025 年度，发行人研发投入分别为 33,344.39 万元、30,512.79 万元和 26,643.93 万元，合计研发投入金额 90,501.11 万元；发行人最近 3 年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 44.87%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，发行人研发人员共 198 人，占发行人员工总数的 64.29%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有可应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 156 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年至 2025 年度，公司营业收入分别为 35,777.31 万元、62,496.77 万元和 103,418.31 万元，公司最近三年营业收入复合增长率为 70.02%

经核查，保荐人认为：发行人符合科创属性指标要求。

#### **（四）保荐人核查程序及核查结论**

保荐人查阅了相关行业报告和市场研究资料，了解了近年来行业相关政策，对发行人所在行业的市场情况和竞争格局进行了分析；对发行人高级管理人员及核心技术人员进行了访谈，查阅了核心技术人员的简历，查看发行人的研发场所和研发设备，查阅发行人研发管理相关制度等文件，了解发行人主要产品的应用领域与发挥的作用；查阅发行人已取得的专利证书，查阅发行人的研发成果及所获荣誉证明；查看发行人的经营场所，核查发行人实际经营情况，对发行人的主要供应商、客户进行了函证及走访、访谈，抽查了发行人的采购、销售合同及订单，对主要客户销售流程及主要供应商采购流程进行了穿行测试。

经核查，保荐人认为，发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和科创属性相关指标要求等科创板定位要求。

### **八、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明**

本保荐人对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐人认为发行人本次发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

#### **（一）符合中国证监会规定的发行条件**

##### **1、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定**

发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

本保荐人查阅了发行人的工商档案、营业执照等有关资料，发行人是由其前身英韧科技（上海）有限公司（以下简称“英韧有限”）整体变更而设立，英韧有限依法成立于2017年6月27日。2023年9月15日，英韧有限召开股东会并作出决议，以2023年7月31日为基准日将英韧有限整体变更为股份有限公司。2023年10月11日，英韧科技取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至本上市保荐书签署日，发行人仍然依法存续。发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，公司按原有限公司账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，自有限公司成立之日起计算，已持续经营三年以上。

截至本上市保荐书签署日，发行人根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，设有健全的股东会、董事会、独立董事、监事会等内部治理结构，组建了由股东会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。同时，公司已根据有关法律、法规及《公司章程》制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等相关规章制度。公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。发行人目前有 11 名董事，其中 4 名为公司选任的独立董事；发行人监事会设 6 名监事，其中监事会主席 1 名，职工代表监事 2 名。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司计划于上市审核阶段根据《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》的规定，择机取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

综上所述，发行人系由有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，自有限责任公司成立之日起计算，已持续经营满三年，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定。

## **2、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定**

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

本保荐人查阅了发行人相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（安永华明（2026）审字第 70059504\_K02 号），发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人报告期内财务状况、经营成果、现金流量。

本保荐人查阅了发行人内部控制制度，确认发行人内部控制所有重大方面是有效的。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（安永华明（2026）专字第 70059504\_K06 号），该报告对于发行人内部控制制度的结论性意见为：“英韧科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

综上所述，发行人会计基础工作规范，内控制度健全有效，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定。

### **3、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定**

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易

本保荐人深入了解发行人的商业模式，查阅了发行人主要合同、走访了主要客户及供应商，与发行人主要职能部门负责人、高级管理人员和主要股东进行了访谈，了解了发行人的组织结构、业务流程和实际经营情况。本保荐人确认发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整、人员、财务、机构及业务独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款之规定。

（2）主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，核心技术人员应当稳定且最近二年内没有

发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更

本保荐人查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东（大）会决议和记录查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告，确认发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定；最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第二款之规定。

（3）不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项

本保荐人查阅了发行人主要资产、核心技术、商标等的权属文件，确认发行人主要资产、核心技术、商标等权属清晰，不存在重大权属纠纷的情况。保荐人核查了发行人相关的诉讼和仲裁文件，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

本保荐人查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告等确认不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对发行人持续经营有重大不利影响的事项。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第三款之规定。

#### **4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定**

（1）发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策

本保荐人查阅了发行人公司章程，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，查阅了发行人主要业务模式及主要产品情况，确认发行人主营业务为数据存储主控芯片与半导体存储产品研发、生产和销售，经营范围为“信息科技、电子科技、物联网技术领域内的技术开发，集成电路及芯片的设计、研发，通讯设备、电子产品、计算机硬件（音像制品、出版物除外）的设计、研发，计算机软件（音像制品、出版物除外）的设计、研发、制作，并提供上述相关领域内的技

术咨询、技术服务及技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询（不含金融、证券、期货），集成电路、计算机软硬件及辅助设备（音像制品、出版物除外）、通讯设备、电子产品的批发、进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

综上所述，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第一款之规定。

（2）最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为

本保荐人获取了相关部门出具的证明文件以及北京市中伦律师事务所出具的法律意见书，确认发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。因此，发行人符合《注册管理办法》第十三条第二款之规定。

（3）董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形

本保荐人取得并查阅了发行人董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监会等网站检索等资料，核对北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。经核查，保荐人认为：发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款之规定。

## （二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

经核查，发行人本次发行前股本总额为 43,026.1427 万元，公司本次拟公开发行股票不低于 47,806,826 股（超额配售选择权行使前），发行人本次发行后股

本总额不低于 47,806.8253 万元（超额配售选择权行使前），发行后发行人股本总额不低于人民币 3,000 万元。

### **（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上**

本次发行后，公司股本总额不低于 47,806.8253 万元，本次拟公开发行不低于 47,806,826 股（超额配售选择权行使前），公开发行股份的比例不低于 10%（超额配售选择权行使前）。

### **（四）市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准**

发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第四套上市标准即“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

发行人 2025 年度实现营业收入为 10.34 亿元，结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司的估值情况，发行人符合所选择的上市标准。

综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第四套上市标准。

### **（五）符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定**

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

## **九、保荐人对发行人持续督导工作的安排**

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况

事项	工作安排
度	
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金使用管理办法》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》《对外担保管理制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项检查
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
（四）其他安排	无

## 十、保荐人对本次发行上市的推荐结论

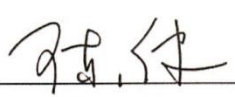

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐人认为，英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件，同意推荐英韧科技股份有限公司本次证券发行上市。


鉴于上述内容，保荐人国泰海通证券股份有限公司推荐发行人英韧科技股份有限公司的股票在贵所上市交易。

（以下无正文）


(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于英韧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人:   
林 韬

保荐代表人:    
陈 健 任 飞

内核负责人:   
杨晓涛

保荐业务负责人:   
郁伟君

法定代表人(董事长):   
朱 健



国泰海通证券股份有限公司

2026 年 6 月 18 日